

杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联人厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须提交股东会审议。

公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士腾科技有限公司（以下简称“士腾科技”）、厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”）的日常关联交易无须提交股东会审议。

● 公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》和《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、罗华兵已回避表决；针对《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权已回避表决；针对《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；针对《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》在董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述日常关联交易议案已经 2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事认为：公司与关联人友旺电子、士腾科技、士兰集科和士兰集宏的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2026 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

关联人	关联交易类别	关联交易内容	交易金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	
友旺电子	向关联人销售货物、提供劳务	出售芯片产成品、提供技术开发服务	不超过 2 亿元	1.64 亿元	不适用
士腾科技	向关联人销售货物	销售芯片	不超过 7,000 万元	4,102 万元	不适用
士兰集科 (注)	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、备品备件等	不超过 40 亿元	31.48 亿元	受市场影响，业务量未达预期
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务、食堂、宿舍、电站运维等	不超过 0.2 亿元	0.17 亿元	不适用
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备品备件以及设备租赁等	不超过 5 亿元	1.62 亿元	受市场影响，业务量未达预期
	向关联人提供劳务	提供加工服务	不超过 1.5 亿元	1.86 亿元	不适用

士兰集宏	向关联人采购商品	采购芯片	/	7.08 万元	不适用
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备品备件等		0.47 亿元	
	向关联人提供劳务	提供加工服务		89.27 万元	

注：公司可根据实际交易情况，在士兰集科的不同关联交易类型间进行额度调剂，总额不超过预计总金额。

(三) 2026 年日常关联交易预计的金额和类别

(币种：人民币)

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2026 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额 (亿元)	2026 年 1-6 月 预计金额 (注)	2025 年实际发生金额 (亿元)	2026 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
友旺电子	向关联人销售货物、提供劳务	出售芯片产成品、提供技术开发服务	0.42	不超过 0.8 亿元	1.64	不超过 2 亿元	不适用
士腾科技	向关联人销售货物等	销售芯片	0.10	/	0.41	不超过 0.6 亿元	不适用
士兰集科	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、备品备件等	8.91	不超过 20 亿元	31.48	不超过 40 亿元	预计业务量增加
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务、食堂、宿舍、电站运维等	0.04	不超过 0.4 亿元	0.17	不超过 0.8 亿元	预计业务量增加
	向关联人销售商品	销售产品、设备、备品备件以及设备租赁等	0.45	不超过 2 亿元	1.62	不超过 5 亿元	预计业务量增加
	向关联人提供劳务	提供加工服务	0.42	不超过 1 亿元	1.86	不超过 2 亿元	不适用
士兰集宏	向关联人采购商品	采购芯片、原材料、设备、备品备件等	0.0002	/	0.0007	不超过 3 亿元	预计业务量增加
	接受关联人提供的劳务	接受加工服务、场地租赁、设备租赁等	0.004	/	0	不超过 0.2 亿元	不适用
	向关联人销售商品、提供劳务	销售产品、设备、备品备件、设备租赁、提供加工服务等	0.003	/	0.48	不超过 0.5 亿元	不适用

注：公司于2025年12月12日召开的第九届董事会第六次会议和2025年12月30日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一关联人的不同关联交易类型间进行额度调剂，总额不超过预计的总金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州友旺电子有限公司

公司名称	杭州友旺电子有限公司		
统一社会信用代码	9133010060916630XC		
成立日期	1994年4月27日		
注册地	浙江省杭州市		
主要办公地点	浙江省杭州市滨江区诚业路1号		
法定代表人	高耿辉		
注册资本	300万美元		
主营业务	半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务		
主要股东	本公司持有40% 友顺科技股份有限公司持有60%		
关联关系类型	本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长，董事罗华兵先生在友旺电子担任董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，友旺电子为公司的关联法人。		
关联人履约能力分析	友旺电子目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约能力。友旺电子未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。		
最近一年及一期的主要财务数据 (单位：万元) (注：合并报表口径)	项目	2025年末/2025年度 (经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
	资产总额	37,056.53	39,739.99
	负债总额	12,272.52	15,407.81
	净资产	24,784.01	24,332.18
	营业收入	36,288.33	35,476.61
	净利润	247.98	2,759.71
	资产负债率(%)	33.12	38.77

（二）杭州士腾科技有限公司

公司名称	杭州士腾科技有限公司
统一社会信用代码	91330108749451700C

成立日期	1994年4月27日		
注册地	浙江省杭州市		
主要办公地点	浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号14号楼2楼		
法定代表人	陈向东		
注册资本	2,046万元		
主营业务	电机控制系统设计和整机系统研发		
主要股东	杭州士兰控股有限公司持有57.36% 本公司持有4.89% 其他股东合计持有37.75%		
关联关系类型	本公司控股股东杭州士兰控股有限公司系士腾科技的控股股东。本公司董事长陈向东先生在士腾科技任董事长，董事郑少波先生在士腾科技任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士腾科技为公司的关联法人。		
关联人履约能力分析	士腾科技目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约能力。士腾科技未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。		
最近一年及一期的主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2025 年末/2025 年度 (经审计)	2024 年末/2024 年度 (经审计)
	资产总额	40,534.75	35,604.74
	负债总额	23,536.68	22,346.82
	净资产	16,998.07	13,257.92
	营业收入	41,879.79	39,661.91
	净利润	3,214.21	4,800.08
	资产负债率 (%)	58.07	62.76

(三) 厦门士兰集科微电子有限公司

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C
成立日期	2018年2月1日
注册地	福建省厦门市
主要办公地点	福建省厦门市海沧区兰英路89号
法定代表人	裴华
注册资本	5,309,503,753元
主营业务	芯片制造
主要股东	厦门半导体投资集团有限公司持有61.987% 杭州士兰微电子股份有限公司持有27.447% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有10.566%
关联关系类型	本公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集科

	董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为公司的关联法人。		
关联人履约能力分析	士兰集科目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约能力。士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。		
最近一年及一期的主要财务数据 (单位：万元)	项目	2025年末/2025年度 (经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
	资产总额	1,046,704.10	931,541.19
	负债总额	646,131.38	575,230.15
	净资产	400,572.72	356,311.04
	营业收入	318,746.60	256,140.02
	净利润	-5,738.32	-12,404.45
	资产负债率(%)	61.73	61.75

(四) 厦门士兰集宏半导体有限公司

公司名称	厦门士兰集宏半导体有限公司		
统一社会信用代码	91350205MADBPM9123		
成立日期	2024年3月6日		
注册地	福建省厦门市		
主要办公地点	福建省厦门市海沧区南海三路999号		
法定代表人	裴华		
注册资本	421,000万元		
主营业务	SiC芯片制造		
主要股东	厦门半导体投资集团有限公司持有23.7530% 厦门新翼微成投资合伙企业(有限合伙)持有26.1283% 厦门产投新翼科技投资合伙企业(有限合伙)持有24.9406% 杭州士兰微电子股份有限公司持有25.1781%		
关联关系类型	本公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集宏董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集宏为公司的关联法人。		
关联人履约能力分析	士兰集宏目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约能力。士兰集宏未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。		
最近一年及一期的主要财务数据 (单位：万元)	项目	2025年末/2025年度 (经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
	资产总额	459,320.27	175,715.93
	负债总额	150,284.64	51,068.46

	净资产	309,035.63	124,647.47
	营业收入	32.19	0
	净利润	-5,061.84	-1,652.53
	资产负债率 (%)	32.72	29.06

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人之间的日常关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及接受、提供劳务等。该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格均以市场价格为基础协商确定，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，定价方式公允、合理，符合相关法律法规及交易所规则的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司与上述关联人将在董事会/股东会审议通过后在已获批准的额度范围内签订具体的交易合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，具有合理的商业实质和业务持续性，有利于推动公司 2026 年生产销售计划的顺利实施，对公司整体经营发展具有积极作用。公司日常关联交易按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价方式公允、合理。该等交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日